

2021年2月5日

各 位

会社名 シャープ株式会社
代表者名 代表取締役 戴正呉
(コード番号 6753)
問合せ先 会長室広報担当 吉田 敦
TEL (050) 5213-6795

(経過開示) 会社分割によるカメラモジュール事業の分社化に関するお知らせ

当社は、2020年5月29日開催の取締役会において2020年度中に当社のカメラモジュール事業を分社化することを決定した旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、2021年4月1日を効力発生日として、今後当社の子会社として新設する会社（以下、「受皿会社」といいます。）に吸収分割で承継させることにより分社化すること（以下、「本分社化」といいます。）を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は完全子会社への吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

1. 本分社化の目的

当社は「輝けるグローバルブランド」をめざし、「ブランド企業への転換」を基本方針の一つに掲げ、事業活動を推進しております。その中で、当社のブランド事業を支える先進のカメラモジュール事業については、分社化により経営責任の明確化を図るとともに、他社からの出資による外部資金の獲得も視野に入れ、変化の激しい事業環境に迅速に対応できるスピーディな意思決定と継続的な設備・開発投資を実行することにより、競争力の維持とさらなる事業拡大をめざしてまいります。

2. 本分社化の要旨

(1) 日程

取締役会決議日	2021年2月5日
受皿会社の設立日	2021年2月9日（予定）
分割契約締結日	2021年2月9日（予定）
実施予定日（効力発生日）	2021年4月1日（予定）

(2) 分社化の方式

本分社化に向けた受皿会社として、シャープセンシングテクノロジー株式会社（以下、「SSTC社」といいます。）を設立します。

この受皿会社を吸収分割承継会社とし、当社を吸収分割会社として、後記(6)記載の事業を吸収分割により承継いたします（以下、「本吸収分割」といいます。）。当社においては会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割、SSTC社においては会社法796条第1項に定める略式吸収分割に該当するため、株主総会の決議を経ずに実施する予定です。

(3) 本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割に際して、SSTC社から当社への株式の割当、金銭その他の財産の交付はありません。

(4) 本吸収分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行する新株予約権に関する取扱いに変更はありません。

(5) 本吸収分割により増加する資本金

本吸収分割に際して当社並びにSSTC社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

カメラモジュール事業に属する資産、負債及びこれらに付随する権利義務を、当社とSSTC社との間で締結する吸収分割契約書に定める範囲において承継します。

(7) 債務履行の見込み

当社並びにSSTC社の債務履行の見込みには問題がないものと判断しております。

3. 本吸収分割の当事会社の概要

(1) 吸収分割会社

① 名 称	シャープ株式会社	
② 所 在 地	大阪府堺市堺区匠町1番地	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役・戴 正 呉	
④ 主 な 事 業 内 容	電気通信機器・電気機器及び電子応用機器全般並びに電子部品の製造・販売等	
⑤ 資 本 金	5,000 百万円	
⑥ 設 立 年 月	1935 年 5 月	
⑦ 発 行 済 株 式 数	532,416,558 株	
⑧ 決 算 期	3 月 31 日	
⑨ 大株主及び持株比率	鴻海精密工業股份有限公司	24.4%
	Foxconn (Far East) Limited	17.2%
	Foxconn Technology Pte. Ltd.	12.1%
	SIO International Holdings Limited	6.6%
⑩ 直前事業年度の連結経営成績及び連結財政状態		
純 資 産	295,138 百万円	
総 資 産	1,832,349 百万円	
1 株 当 たり 純 資 産	450.70 円	
売 上 高	2,271,248 百万円	
営 業 利 益	52,773 百万円	
経 常 利 益	55,541 百万円	
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	20,958 百万円	
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	34.31 円	

(2) 吸収分割承継会社

① 名 称	シャープセンシングテクノロジー株式会社	
② 所 在 地	奈良県天理市櫛本町 2613 番地の 1	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役・藤田 直哉	
④ 主 な 事 業 内 容	電子デバイス（カメラモジュール、センサーモジュール等）の企画・開発・生産・販売	
⑤ 資 本 金	100 百万円	
⑥ 設 立 年 月	2021 年 2 月（予定）	
⑦ 発 行 済 株 式 数	2,000 株（予定）	
⑧ 決 算 期	3 月 31 日	
⑨ 大株主及び持株比率	当社 100%	

※吸収分割承継会社は今後設立予定であり、直前事業年度の経営成績等はございません。

4. 分割する事業の概要

① 事業内容	電子デバイス（カメラモジュール、センサーモジュール等）の企画・開発・生産・販売	
② 営業成績（2020年3月期）		
売上高	333,414百万円	
③ 分割する資産、負債の項目及び帳簿価額（2020年12月31日時点）		
流動資産	31,587百万円	
固定資産	515百万円	
流動負債	397百万円	
固定負債	0百万円	

※営業成績には、他セグメントへの内部売上高を含んでおります。

※「分割する資産、負債の項目及び帳簿価額」は現時点で予定する資産、負債に関するものであり、分割する対象を含め変動することがあります。

※帳簿価額は、2021年3月期第3四半期に関する監査前の金額です。

5. 本吸収分割後の状況

当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

SSTC社の所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はない予定です。

6. 今後の見通し

本吸収分割は子会社への吸収分割であるため、当社連結業績への影響は軽微です。

以上